**ICT测试治具测试点的技术要求：**

1. 测试点到PCB边缘的距离应大于3.175(125miL)；

2. 测试焊盘的中心间距应大于2.54mm(100min)；

3. 测试点为圆形(直径1mm以上)或方形1mm\*1mm以上)；

4. 不能将SMT元件，插件元件的焊盘作为测试点；

5. 网络布板后，保证每个测试点都有网络属性；

6. 测试点与焊接面上的元件间距应大于2.54mm；

7. 保证PCB上所有的网络必须有一个以上的测试点；

8. 测试点尽可能的全部布置在焊接面上；

9. 没有连接元件的网络,网络名不能相同；

10. 测试点需做好标注(TP1、TP2...)，且尽量固化。

**ICT测试治具定位孔的技术要求：**

1. 放置时应尽量拉开距离，且距离板边缘至少有2mm以上的间距；

2. 主控板也就是PCB板上要有点个以上不对称的定位孔；

3. 定位孔离测试焊盘中心的间距在3mm以上；

4. 定位孔.安装孔周围0.5mm范围内不能有铜箔（防止过波峰时孔内填锡）；

5. 显示板单板上要有2个以上不对称的定位孔；

6. 定位孔孔径为4mm，3mm，2.7mm，直径误差为正负0.05/-0mm，孔距的公差要求在正负0.08mm之内；

7. 定位孔必须是圆形的。

**测试点的设计要求：**

1.定位孔采用非金属化的定位孔 ，误差小于0.05mm。定位孔周围3mm不能有元件。

2.测试点直径不小于0.8mm，测试点之间的间距不小于1.27mm,测试点离元件不小于1.27mm，否则锡会流入到测试点上。

3.如果在测试面放置高度超过4mm的元器件，旁边的测试点应避开，距离4mm以上，否则测试治具不能植针。

4.每个电气节点都必须有一个测试点，每个IC必须有POWER及GROUND的测试点，且尽可能接近此元器件，最好在距离IC 2.5mm范围内 。

5.测试点不可被阻焊或文字油墨覆盖，否则将会缩小测试点的接触面积，降低测试的可靠性 。

6.测试点不能被插件或大元件所覆盖、挡住。

7.不可使用过孔或DIP元件焊点做测试点。